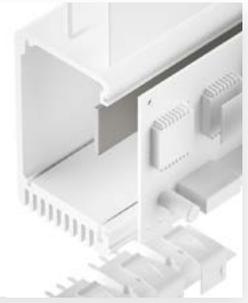


# SILIKON GAP-FILLER PAD TGF-USS-SI



sehr weich, elastisch / minimierte volatile Siloxane (LV)

TGF-USS-SI ist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfähiger Gap-Filler aus LV Silikon, mit dem sich sehr gute thermische Anbindungen über große Spaltmaße, z.B. durch Höhenunterschiede elektronischer Bauelemente oder große Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Füllung des Silikonelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine sehr hohe thermische Leitfähigkeit. Durch seine ultra Weichheit und Formanpassungsfähigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei minimalem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtübergangswiderstand minimiert. Durch seine natürliche Haftfähigkeit lässt sich das Material sehr gut vorapplizieren. Durch einen einseitig aufgetragenen wärmeleitenden Film ist das Material einseitig nicht haftend.



Stand 06 / 2024

### EIGENSCHAFTEN

- Ultra weich und formanpassungsfähig
- Minimierter volatiler Siloxananteil (LV)
- Keine Lackabweisung
- Wärmeleitfähigkeit: 3,3 W/mK
- Wirkung bei minimalem Druck
- Extrem alterungs-/chemisch beständig
- Vibrationsdämpfend
- Leichte Vormontage durch Selbsthaftung
- Einseitig selbsthaftend

### LIEFERFORMEN

- Matte 200 x 200 mm (1,0 – 3,0 mm Dicke)
- Matte 200 x 400 mm (1,0 – 3,0 mm Dicke)
- Einseitig haftend durch Filmlaminat (TGF-USSXXX-SI-A1)
- Als lose Einzelteile
- Als Kiss Cut Formteile auf Bogen

### ANWENDUNGSBEISPIELE

- Thermische Anbindung von z.B.
- SMD Bauteilen
  - Through-hole Vias
  - RDRAM Speicherbausteine
  - Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs z.B. in Automotiveanwendungen / Notebooks / Medizintechnik / Embedded-Boards

Technisches Datenblatt

Unsere technischen Angaben und Daten erfolgen nach bestem Wissen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und stellen lediglich unverbindliche Informationen in Bezug auf die Produktanwendung in einer Applikation sowie etwaige Schutzrechte Dritter dar. Sie befrein nicht von der Durchführung eigener Prüfungen. Verwendung und Verarbeitung der Produkte liegen außerhalb unserer Kontrolle und sind im Verantwortungsbereich des Anwenders. Änderungen der Angaben bleiben vorbehalten.

EIGENSCHAFT	EINHEIT	TGF-USS1000-SI-A1	TGF-USS2000-SI-A1	TGF-USS3000-SI-A1
<b>MATERIAL</b>				
Farbe		Silikon mit Keramikfüllung Dunkelgrau / Grau	Silikon mit Keramikfüllung Dunkelgrau / Grau	Silikon mit Keramikfüllung Dunkelgrau / Grau
Dicke	mm	1,0 <sup>+0,20</sup> / <sub>-0,10</sub>	2,0 <sup>+0,20</sup>	3,0 <sup>+0,30</sup>
Härte	Shore 00	45	45	45
Keine Lackabweisung (LABS) <sup>1</sup>		Ja	Ja	Ja
Entflammbarkeit (Äquivalent)	UL 94	V0	V0	V0
RoHS Konformität	2015 / 863 / EU	Ja	Ja	Ja
<b>THERMISCH</b>				
Widerstand <sup>2</sup> @ 400 kPa @ Dicke	°C-inch <sup>2</sup> /W (mm)	0,40 (0,87)	0,63 (1,55)	0,75 (1,84)
Widerstand <sup>2</sup> @ 200 kPa @ Dicke	°C-inch <sup>2</sup> /W (mm)	0,45 (0,93)	0,70 (1,70)	0,94 (2,30)
Widerstand <sup>2</sup> @ 70 kPa @ Dicke	°C-inch <sup>2</sup> /W (mm)	0,51 (0,99)	0,80 (1,85)	1,07 (2,68)
Thermische Leitfähigkeit <sup>1</sup>	W/mK	3,3	3,3	3,3
Betriebstemperaturbereich	°C	- 40 bis + 150	- 40 bis + 150	- 40 bis + 150
<b>ELEKTRISCH</b>				
Durchschlagsfestigkeit	kV / mm	>10	>10	>10
Durchgangswiderstand	Ohm - cm	1,0 x 10 <sup>10</sup>	1,0 x 10 <sup>10</sup>	1,0 x 10 <sup>10</sup>

Testmethode: <sup>1</sup> P-VW 3-10.7 57650 Temp. Test, <sup>2</sup> ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 1,0 mm / 2,0 mm / 3,0 mm

mm vs. N/cm<sup>2</sup> (PSI) / Rth vs. N/cm<sup>2</sup> (PSI)

